(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月25日(25.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/197662 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/008922

(22) 国際出願日： 2025年3月11日(11.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-047034 2024年3月22日(22.03.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

(72) 発明者: 田代 佳(**TASHIRO, Kei**); 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 本田 勝(**HONDA, Masaru**); 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人ＩＴＯＨ(**ITOH PATENT ATTORNEY CORPORATION**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル １６階 (JP).

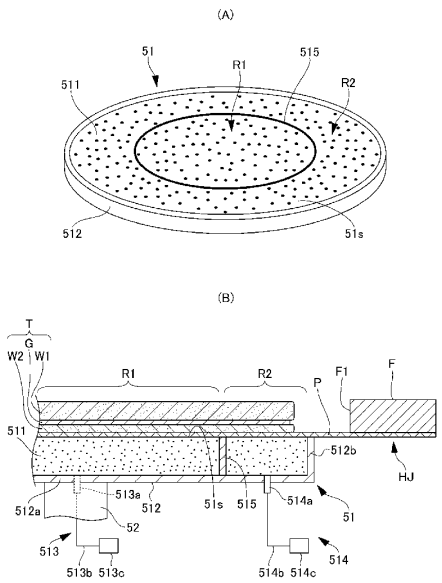
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

WO 2025/197662 A1

(54) **Title:** SEPARATION DEVICE AND HOLDING METHOD

(54) 発明の名称： 剥離装置、および保持方法

[図8]



(57) **Abstract:** This separation device performs separation with respect to a multilayer substrate in which a first substrate and a second substrate are joined. With respect to a holding jig that has a dicing frame which has an opening and dicing tape which is fixed to the dicing frame so as to cover the opening, the multilayer substrate is affixed to the dicing tape by being disposed in the opening. The separation device has a holding part that holds the multilayer substrate by suctioning the dicing tape of the holding jig. The holding part includes a center region and an outer peripheral region that is divided from the center region and that surrounds the center region from the outside. The holding part applies a suction pressure, which is for suctioning the dicing tape, to each of the center region and the outer peripheral region.

(57) 要約：剥離装置は、第１基板と第２基板とを接合した重合基板を剥離する。重合基板は、開口部を有するダイシングフレームと、開口部を塞ぐようにダイシングフレームに固定されたダイシングテープと、を有する保持治具に対して、開口部に配置されることでダイシングテープに貼り付けられている。剥離装置は、保持治具のダイシングテープを吸着して重合基板を保持する保持部を有する。保持部は、中央領域と、中央領域に対して区画され当該中央領域の外側を周回する外周領域と、を含み、中央領域および外周領域の各々においてダイシングテープを吸着する吸着圧力を付与する。

［続葉有］

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告(条約第21条(3))